

**2019**



北京世纪金光半导体有限公司  
Beijing Cengguo Semiconductor Co.,Ltd

» 矢志发展  
步履始终向前

» 2005年

改制

河南新乡神舟晶体  
第二代半导体材料研发与生产



» 2010年

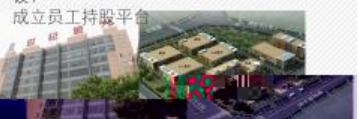
升级

北京世纪金光  
第三代半导体产业化



» 2016年

第一款SiC MOSFET器件研发成功；  
第一款GaN HEMT器件研发成功；  
承担了第一个“军民融合SiC三端器件”国家重大专项任务；  
收购首钢微电子公司器件前道工艺生产线；  
启动GaN全产业链工业生产线全面建设；  
成立员工持股平台



» 1970年

始建

中原半导体研究所  
第一代半导体材料研发与生产

成

» 2008年

转型

北京华进创威  
第三代半导体材料研发与生产



» 2015年

完成第一次股改；  
第一款SiC SBD研制成功；  
开始SiC全产业链工业生产线建设。

国家半导体产业发展基金投资“世纪金光”；  
实现第二轮股改；  
“企业研发中心”被开发区评为“北京经济技术开发区研发机构”，获批“第三代半导体功率器件设计与验证北京市工程实验室”。  
SiC从粉料到功率器件产业链建成并投产；

» 2017年

